

Nazwa	Opis	Aplikacja	Przewodność cieplna	Lepkość [cP]
9-20801	<ul style="list-style-type: none"> Szybko utwardzany Możliwe utwardzanie w zaciemnionych miejscach Tiksotropowy 	<ul style="list-style-type: none"> Klejenie radiatorów do PCB Rozpraszanie ciepła 	0,9 W/mK	110 000
501-E	<ul style="list-style-type: none"> Bezrozpuszczalnikowy Niska lepkość, idealna dla metody sprayu lub pędzla 	<ul style="list-style-type: none"> aktywator 		30-40